

FQ 2,54D/ 30-PH-1-BT - Stiftleiste

1156943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1156943>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

SMD-Stiftleiste, Nennstrom: 3 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 30, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten



Ihre Vorteile

- Zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen durch doppelseitiges Kontaktsystem
- Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
- Klares und kostenoptimiertes Design
- Geeignet für eine Vielzahl von Applikationen
- Gestapelte, koplanare oder orthogonale Leiterplattenverbindungen erlauben höchste Flexibilität im Gerät

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1156943
Verpackungseinheit	130 Stück
Mindestbestellmenge	130 Stück
Verkaufsschlüssel	E2 - Board to Board StVb
Produktschlüssel	AAXGBA
GTIN	4063151160340
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,446 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Die zulässige Spannung im Betrieb ergibt sich in Abhängigkeit von der Anwendung unter Berücksichtigung der Luft- und Kriechstrecken im Rahmen der Isolationsanforderungen gemäß IEC 60664-1.
---------------------	--

Artikeleigenschaften

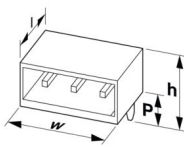
Produkttyp	SMD-Stiftleiste
Produktfamilie	FQ 2,54D/...-PH
Polzahl	30
Rastermaß	2,54 mm
Anzahl der Reihen	2
Pinlayout	Lineare Pad-Geometrie

Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften

Nennstrom I_N	3 A (bei 20 °C 80-polig)
Durchgangswiderstand	20 mΩ
Prüfspannung	500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05

Maße

Maßzeichnung	
Rastermaß	2,54 mm
Breite [w]	38,1 mm
Höhe [h]	6,28 mm
Länge [l]	16,1 mm
Bauhöhe	5,08 mm

Anwendung

Kontaktüberdeckung	0,4 mm
Überstecklänge	1,3 mm

Leiterplatten-Design

Pad-Geometrie	1,3 x 2,8 mm
---------------	--------------

Materialangaben

Materialangaben - Kontakt

Hinweis	WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC
---------	---

	JESD 201
Material Kontakt	Cu-Legierung
Oberflächenbeschaffenheit	Selektivbeschichtung
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Gold (Au)
Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht)	Nickel (Ni)
Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht)	Zinn (Sn)

Materialangaben - Gehäuse

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Isolierstoff	PA
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Steckverbinder

Anschluss 1

Isolierstoff	PA
CTI nach IEC 60112	600

Elektrische Prüfungen

Thermische Prüfung | Prüfgruppe C

Prüfspezifikation	IEC 60512-5-2:2002-02
Geprüfte Polzahl	80

Isolationswiderstand

Prüfspezifikation	IEC 60512-3-1:2002-02
Isolationswiderstand benachbarte Pole	> 1 GΩ

Luft- und Kriechstrecken |

Isolierstoffgruppe	I
Mindestwert der Luft- und Kriechstrecke	0,4 mm

Mechanische Prüfungen

Steck- und Ziehkräfte

Ergebnis	Prüfung bestanden
Anzahl der Zyklen	100
Steckkraft je Pol ca.	2,9 N
Ziehkraft je Pol ca.	2,9 N

Sichtprüfung

Prüfspezifikation	IEC 60512-1-1:2002-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

Maßprüfung

Prüfspezifikation	IEC 60512-1-2:2002-02
-------------------	-----------------------

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	IEC 60068-2-6:2007-12
Frequenz	10 - 55 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	1,52 mm
Beschleunigung	181 m/s ²
Prüfdauer je Achse	2 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Lebensdauerprüfung

Prüfspezifikation	IEC 60512-9-1:2010-03 (in Anlehnung)
Durchgangswiderstand R ₁	20 mΩ
Durchgangswiderstand R ₂	30 mΩ
Steckzyklen	100
Isolationswiderstand benachbarte Pole	> 1 GΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C

Montage

Montageart	SMD-Löten
Pinlayout	Lineare Pad-Geometrie

Verarbeitungshinweise

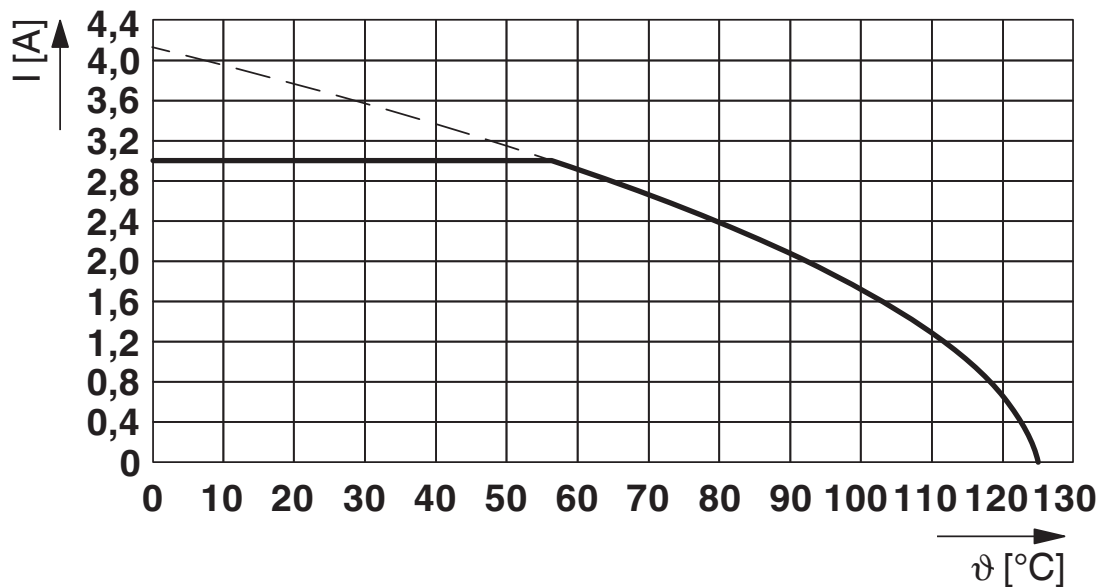
Prozess	Reflowlötung
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T _c	260 °C

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Stangenmagazin
----------------	----------------

Zeichnungen

Diagramm



Typ: FQ 2,54D/...-SH-O-BT mit FQ 2,54D/...-PH-1-BT

FQ 2,54D/ 30-PH-1-BT - Stiftleiste



1156943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1156943>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1156943>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E118976				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	30 V	3 A	-	-

FQ 2,54D/ 30-PH-1-BT - Stiftleiste

1156943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1156943>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FQ 2,54D/ 30-PH-1-BT - Stiftleiste



1156943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1156943>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de